

中信证券股份有限公司
关于贵州振华风光半导体股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 4 月 17-18 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1. 研发未达预期风险

公司围绕市场需求，开展核心技术研发、新产品拓展、技术升级改造等工作，投入了大量的资金和人力，公司技术成果的产业化和市场化进程具有不确定性，如果在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入无法收回且难以实现预计效益的风险，并将对公司业绩产生不利影响。

2. 研发人员不足或流失的风险

集成电路行业是技术密集型行业，关键技术和人才是公司保持持续竞争优势的基础，随着技术研发的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时加大对高端、复合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸

引和培养更加优秀的技术人才，或者出现研发人员流失的情况，都将会导致公司的竞争力下降。

（二）经营风险

1.客户集中度较高风险

报告期内，由于公司下游客户主要以央企及其下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户形成了密切配合的合作关系，按照特种元器件供应的体系，通常定型产品的供应商不会轻易更换，且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场，减少客户集中度高的潜在不利影响。但若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

2.税收政策变动的风险

国家一直以来重视集成电路企业的政策支持，公司作为高新技术企业，享受着国家税收政策优惠，但是未来若国家相关税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩带来不利影响。

3.募投项目延期或无法按期实施的风险

公司于2024年3月13日审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将两项募投项目的建设期进行延长，其中高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目计划变更为于2025年12月31日前完成项目建设；研发中心建设项目计划变更为于2024年12月31日前完成项目建设。公司于2024年12月24日审议通过了《关于研发中心建设项目延期的议案》，将研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延长半年，预计达到可使用状态日期为2025年6月30日。

但公司上述两项募投项目仍存在延期或者无法按期实施的风险。

（三）财务风险

1.应收账款及应收票据余额较高的风险

报告期公司业务规模不断扩大，应收账款的余额相应增长。由于特种领域产

品验收程序严格和复杂，同时受客户主要以商业票据结算为主的影响，导致公司应收账款、应收票据的规模较大。虽然公司客户主要为央企及其子公司，整体信誉较好，支付能力较强，但若公司不能有效提高应收票据及应收账款管理水平及保证回款进度，将有可能出现应收票据及应收账款持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司经营成果造成不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化应收账款回款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

2. 存货金额较大及发生减值风险

随着公司业务规模的不断扩大，为满足生产经营需要，公司存货相应增加。受产品种类型号多、验收程序繁琐等因素的影响，公司储备的原材料较大，客户尚未验收的发出商品余额较大，导致存货余额较高。同时，公司积极应对客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期客户的需求，对部分产品提前备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

风险管理措施：一方面公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制，同时加强销售队伍建设，不断完善客户需求分析管理体系，合理备货；另一方面严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

（四）行业风险

1. 需求端的放缓或调整，引起市场竞争格局变化，价格成本控制更加敏感，供应链的稳定性和需求预测变得更加重要。

2. 下游需求及产品销售价格波动风险，如未来受行业环境因素的影响，如果高可靠集成电路的下游市场需求出现一定波动，或者因市场竞争加剧导致产品销售价格有所下降，从而对公司销售收入及毛利率等经营业绩指标造成不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增 减(%)	2022 年
营业收入	106,310.74	129,712.44	-18.04	77,887.40
归属于上市公司股东的净利润	32,253.77	61,060.61	-47.18	30,301.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,033.49	58,717.66	-50.55	29,236.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,658.39	-3,235.50	不适用	-22,586.75
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	492,555.07	472,895.55	4.16	419,387.19
总资产	548,218.92	536,046.77	2.27	481,992.97

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增 减(%)	2022 年
基本每股收益（元 / 股）	1.6127	3.0530	-47.18	1.8181
稀释每股收益（元 / 股）	1.6127	3.0530	-47.18	1.8181
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.4517	2.9359	-50.55	1.7542
加权平均净资产收益率（%）	6.69	13.71	减少 7.01 个百分点	16.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.02	13.18	减少 7.16 个百分点	15.74
研发投入占营业收入的比例（%）	13.54	11.80	增加 1.74 个百分点	11.31

(1) 营业收入同比下降 18.04%，主要系报告期内，受国内高可靠行业整体需求下降，客户去库存行为等的影响，公司销售订单增长不及预期，同时因税收优惠政策变更及产品降价的因素，营业收入规模同比下降。

(2) 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 47.18%和 50.55%，主要原因：一是受国内高可靠行

业需求下降、税收优惠政策变更、产品降价的影响，营业收入和产品毛利率下降；二是闲置募集资金开展现金管理取得的利息收入和投资收益大幅减少；三是应收款项增加，计提的信用减值损失增加。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 22,422.89 万元，主要系高可靠领域客户中期调整，项目经费拨付暂缓，报告期内销售商品及劳务取得的现金同比减少，同时因税收优惠政策变更，报告期缴纳的增值税及附加税同比增加所致。

(4) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降 47.18%、47.18%和 50.55%，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。

(5) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别下降 7.01 个百分点、7.16 个百分点，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司的核心竞争力

1. 研发方面

公司作为国内最早从事模拟集成电路研发和生产的厂商之一，多年来立足国产化的需求和创新，持续加大研发投入和技术体系革新，依托自主搭建的研发设计平台，积极拓宽产品谱系，在模拟、数模混合及系统集成等领域积累了大量的技术经验。

在研发模式上，形成“五位一体”（贵阳、成都、西安、南京、上海）的异地协同研发方式，同时积极与复旦大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学等高校进行合作，通过共建联合实验室以及项目合作等方式，进一步强化产学研科技创新和产业创新深度融合。

在研发流程上，具备完整的集成电路前后端设计流程，覆盖基于 Bipolar、CMOS、BiCMOS、BCD、抗辐射双极工艺、GaAs 工艺的产品开发能力，工艺节点覆盖 4 μ m 至 28nm。通过开发商用工艺线自主器件模型库，定制化解决用

户特殊应用需求，提升极限条件下的设计准确性，提高产品的差异化竞争力。具备了超大规模千万门级 ASIC、SiP、RISC-V 架构 MCU 及国产化系统芯片级解决方案设计能力；注重算法设计与建模分析，实现从芯片设计、封装设计、测试开发、检测试验到辐照设计的全流程自主可控研发流程，提高核心竞争力。

在研发平台上，建成满足超大规模模拟集成电路、数模混合信号集成电路、数字集成电路设计仿真与版图验证的全流程异地协同计算集群能力，提供迭代仿真计算产生的大量数据的存储空间，支持多人并行协同设计，为集成电路设计、数据存储、计算任务调度提供软硬件支撑，用户容量满足 600 人同时在线设计。

在产品布局上，形成高可靠放大器、专用转换器、接口电路、电源管理器、驱动器、信号调理器、信号开关电路、微处理器、存储器、电机控制系统、信号调理系统、射频微波系统、微特电机及组件、抗辐照等多细分领域产品谱系，为用户提供完整的模拟集成电路全域解决方案。

2.制造能力方面

公司在 GJB9001C 质量管理体系的基础上，深化新时代质量管理体系建设，并且获得 3 级-认定，在高可靠元器件行业质量管理水平国内领先，公司高度重视产业链管理，以协同全产业链质量管理模式向行业推广应用，同时公司顺利通过 IATF16949 质量管理体系认证，标志着公司在汽车领域元器件产品的技术和质量管理标准获得行业认可。公司积极推进管理创新、导入卓越绩效管理模式，推行精益生产管理模式，开展 FMEA、六西格玛等质量工具培训和运用，《基于全过程全链条管理构建集成电路产业创新生态体系》荣获中国电子 2024 年度管理创新三等奖。《创新运用六西格玛提升元器件制造关键过程质量管控水平》成功入围工业和信息化部 2024 年度质量提升与品牌建设典型案例的遴选。

封装种类覆盖金属封装、陶瓷封装和塑料封装三大类，包括 SOP、QFN、QFP、BGA 等十多个类型一百多个品种，最高引出端数达 2000 PIN，最高工作频率可达 20GHz，具备高密度、高可靠的单芯片封装，多芯片叠层封装和 SiP 系统级封装能力，可满足 2000 线以内 CPU、FPGA、AD/DA、交换芯片等中高端集成电路和高密度系统级封装的代工需求。

3.测试能力方面

公司首次基于 V93K 实现 SSD、EMMC 等 6 类存储器、18 位 AD 转换器的测试突破，初步建成 300V/100A 大功率驱动器测试平台，攻克放大器-100dBc 的谐波失真等动态特性指标测试，围绕公司多方向产品体系，攻克 0.02° 分辨率的磁编码测试，搭建 40GHz 的射频微波测试平台，实现 8 位 MCU 单片机及 32 位 DSP 数字信号处理器测试，解决温度系数 5ppm、电压精度 0.03% 的电源类产品测试难题。依托上述核心技术突破与自主创新能力，公司构建起覆盖多领域、多场景的完整测试体系，形成以高精度、宽频段、全品类适配为特色的核心竞争力，为行业客户提供从芯片级到系统级的全栈式测试解决方案。

4.市场方面

公司作为国内最早从事模拟集成电路研发和生产的厂商之一，始终围绕高可靠电子产业的发展不断丰富产品种类、提升生产制造水平、强化质量过程控制，多类产品已在行业内占据主要地位，与同行业公司相比，服务能力、响应速度、产品应用经验等均具有明显优势。在市场拓展方面，坚持以用户为中心，报告期内推出新产品 100 余项，进一步夯实公司市场基础。在销售渠道方面，公司已建立七大片区 15 个销售网点，营销及 FAE 共 60 余人常年驻扎片区，实现全方位全领域覆盖，公司信号链产品长期占据市场主导地位，产品广泛应用于各领域当中，包括近年兴起的无人机、无人艇、商业航天、商飞（试样阶段）及低成本装置等。

为应对日益激烈的市场竞争，通过建立市场技术开发部，加入 FAE 和 AE 队伍到市场营销团队中，形成以客户、方案及交付三个团队为一体的三角营销模式，重点布局新产品推广、新用户开发和新市场拓展；与用户建立联合开发、联合应用验证等新型销售模式，重点以模块、模组、板卡等系统解决方案，实现配套层升级，掌握市场选型控制权。在客户关系维护中，重点客户实现一对一或二对一模式，即销售专人值守或销售+FAE 二对一值守，深度挖掘客户需求，实现维稳拓潜，并通过中国振华与各领域重点客户签订战略合作伙伴关系，实现选型、交付及货款优先。除传统业务外，公司正加紧布局新领域、新市场，主要以国际化、商业航天、商飞、车规、低成本及民用装备市场，打造新市场。

近年来，公司在产品质量提升、交付周期缩短、价格优惠及高品质服务四个维度得到客户广泛认可，部分客户开展供应商绩效评价，在各领域客户中获得“金牌供应商”、“优秀供应商”、“品质卓越奖”及“感谢信”等 50 余次，充分体现客户对公司的高度认可。

5.人才方面

公司高度重视人才团队建设，积极营造平等、互相帮助、互相成就的工作氛围，通过多措并举创新人才激励机制及优秀的企业文化，吸引人才、留住人才、凝聚人才，激励优秀人才与公司共同发展。公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，在模拟、混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富经验，并在“贵阳+成都”基础上，建立西安、南京、上海研发中心，为公司可持续发展提供有力保障。报告期内，公司通过“柔性引才+精准引智”实施，创新构建多层次人才体系，报告期末，公司研发人员占比 29.07%（其中硕士及以上学历研发人员占比 41.60%），核心技术骨干平均从业年限超 8 年，依托文化凝聚与机制创新双引擎，以系统性人才战略持续巩固行业技术领先地位，为公司产品保持先进性提供必要条件。

6.企业文化

公司围绕“拼搏奉献、担当务实、创新发展、卓越共赢”的核心价值观，创立良好的企业文化环境，并指导员工在具体行动中实践公司“科技为先、质量为本、用户至上、诚信共赢”的经营理念。公司始终做到以人为中心，把员工视为文化建设的主要对象和企业的最重要资源，通过不断调动员工的积极性和创造性，以实现公司“百年风光梦，幸福风光人”的公司愿景，实现员工自身价值的升华和企业蓬勃发展的有机统一。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	14,395.62	15,305.38	-5.94
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	14,395.62	15,305.38	-5.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.54	11.80	增加 1.74 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	/	/	/

研发费用同比下降 5.94%，主要系本期新立项的科研项目较多，大量项目处于设计阶段，领用的晶圆和各种验证用材料同比减少所致。

（二）研发进展

报告期内，公司有 1 项技术成果通过中国电子信息产业集团有限公司组织的成果鉴定，成果名称为高性能开关转换器关键技术。高性能开关转换器关键技术在高精度技术和低失调放大器电路技术上进行设计创新，申请发明专利 4 件，其中授权发明专利 2 件，集成电路布图设计登记 2 件，成果技术达到国内领先水平。

报告期内，公司在集成电路设计领域，申请发明专利 40 件、实用新型专利 3 件、集成电路布图设计 43 件，软件著作权 1 件；在集成电路封测领域，申请发明专利 5 件、软件著作权 2 件。通过成果积累，积极参与了 2023 年度贵州省科技进步奖的评选，2023 年度“航空航天器专用高性能单片集成转换器关键技术研究与应用”获贵州省科技进步二等奖。

报告期内获得的知识产权列表：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	45	10	139	46
实用新型专利	3	4	89	86
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	3	3	7	7
其他	43	58	218	215
合计	94	75	453	354

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度相比原计划有所延后，公司已审议通过募投项目延期的议案，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有公司 40.12% 的股份。公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其通过持有中国电子有限公司与中国振华股权间接控制振华风光 40.12% 的股份，并通过中电金投间接控制振华风光 2.92% 的股份，合计控制振华风光 43.04% 的股份。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股票，通过员工持股平台贵州风光智管理咨询合伙企业（有限合

伙）（以下简称“风光智”）及贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风光芯”）间接持有公司股票情况如下：

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	质押或冻结情况
1	朱枝勇	董事长	无	无质押或冻结
2	张国荣	董事长（离任）	持有风光芯 6.04%的出资份额	无质押或冻结
3	赵晓辉	副董事长	持有风光智 4.08%的出资份额	无质押或冻结
4	胡锐	董事、总经理、核心技术人员	持有风光智 3.26%的出资份额	无质押或冻结
5	刘宗永	总法律顾问	持有风光芯 3.62%的出资份额	无质押或冻结
6	刘岗岗	副总经理	持有风光芯 3.62%的出资份额	无质押或冻结
7	唐拓	副总经理	持有风光智 3.26%的出资份额	无质押或冻结
8	段方	副总经理	持有风光智 2.24%的出资份额	无质押或冻结
9	刘健	副总经理	持有风光芯 3.62%的出资份额	无质押或冻结
10	张博学	总会计师、董事会秘书	持有风光芯 1.13%的出资份额	无质押或冻结
11	李政	核心技术人员	持有风光智 1.73%的出资份额	无质押或冻结
12	李平	核心技术人员	持有风光智 1.30%的出资份额	无质押或冻结
13	唐毓尚	核心技术人员	持有风光智 2.45%的出资份额	无质押或冻结
14	夏良	核心技术人员	持有风光智 0.87%的出资份额	无质押或冻结
15	李雪	核心技术人员	持有风光智 0.87%的出资份额	无质押或冻结

注 1：公司高级管理人员和部分核心员工参与认购的中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已于 2023 年 8 月 28 日上市流通；自上市流通后，该资管计划累计减持公司 3,713,333 股，截至 2024 年 12 月 31 日，该资管计划已不持有公司股份。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，风光智直接持有公司股份 776,980 股，风光芯直接持有公司股份 629,369 股。

除上述情况外，截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

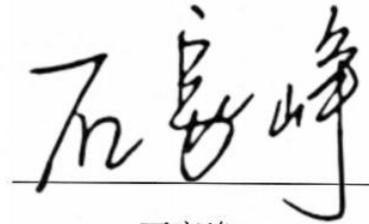
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



马 峥



石家峥

